

# 2026年3月期 決算説明資料

2026年5月11日

[Click here for the English Ver](#)



This material is the property of TOWA CORPORATION

## 主な説明内容

---

**1. 2026年3月期 実績**

**2. 2027年3月期 予想**

**3. TOPICS**

## 主な説明内容

---

**1. 2026年3月期 実績**

2. 2027年3月期 予想

3. TOPICS

## 2026年3月期 サマリー

受注高 595.6 億円 (前年同期比 +25.6%)	売上高 543.6 億円 (前年同期比 +1.7%)	営業利益 69.1 億円 (前年同期比 ▲22.1%)	経常利益 69.4 億円 (前年同期比 ▲26.1%)	当期純利益 45.9 億円 (前年同期比 ▲43.4%)
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

### ▶ 受注高

- ・ AI・データセンター向けを中心に2Q以降好調に推移し、過去2番目の受注高を記録。
- ・ メモリや先端パッケージ向け投資の増加によりコンプレッション装置・金型の受注は過去最高を記録。

### ▶ 売上高

- ・ 受注同様メモリや先端パッケージ向けなどAI・データセンター向けが好調で過去最高の売上高を記録。
- ・ メモリ向け投資の増加により、シンギュレーション装置の売上高が大幅に増加。

### ▶ 利益

- ・ 売上高は増加したものの、製品ミックス変動や初回納入に伴う追加コストの影響により減益。

こちらは2026年3月期決算のサマリーです。

受注高につきましては、AI・データセンター向けを中心に第2四半期以降好調に推移し、過去2番目の受注高を記録いたしました。  
また、メモリや先端パッケージ向け投資の増加によりコンプレッション装置・金型の受注は過去最高を記録いたしました。

売上高につきましては、受注同様メモリや先端パッケージ向けなどAI・データセンター向けが好調で過去最高の売上高を記録いたしました。  
また、主力のモールディング装置だけでなく、メモリ投資の増加により、シンギュレーション装置の売上高も大幅に増加いたしました。

各段階利益につきましては、売上高は増加したものの、トランスファ装置における製品ミックスの悪化やコンプレッション装置における初回納入に伴う一時的な追加コストの影響を受け、減益となりました。

## 2026年3月期 連結業績結果

(単位：億円)

	2025/3期 実績	2026/3期 実績	前期比	2026/3期 修正予想	予想比
売上高	534.7	543.6	+ 8.8 (+ 1.7%)	545.0	▲ 1.3 (▲ 0.2%)
営業利益	88.8	69.1	▲ 19.6 (▲ 22.1%)	70.0	▲ 0.8 (▲ 1.2%)
営業利益率	16.6%	12.7%	▲ 3.9pt	12.8%	▲ 0.1pt
経常利益	94.0	69.4	▲ 24.5 (▲ 26.1%)	70.0	▲ 0.5 (▲ 0.8%)
当期純利益	81.2	45.9	▲ 35.2 (▲ 43.4%)	49.5	▲ 3.5 (▲ 7.2%)

※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

こちらは通期の業績結果です。

売上高は、メモリ分野で高い採用実績を有する当社モールドディング装置の需要を着実に取り込んだ結果、前期比で増収となりました。

利益につきましては、製品ミックス変動の影響や初回納入に伴う一時的な追加コストの影響を受け、各段階利益ともに前期比で減収となりました。

詳細については、12ページの増減要因分析をご覧ください。

## 2026年3月期 セグメント別売上高

(単位：億円)

	2025/3期 実績	2026/3期 実績	前期比	2026/3期 修正予想	予想比
<b>売 上 高</b>	<b>534.7</b>	<b>543.6</b>	<b>+ 8.8</b> (+ 1.7%)	<b>545.0</b>	<b>▲ 1.3</b> (▲ 0.2%)
<b>半 導 体 事 業</b>	<b>395.3</b>	<b>403.9</b>	<b>+ 8.6</b> (+ 2.2%)	<b>399.8</b>	<b>+ 4.1</b> (+ 1.0%)
<b>メ デ ィ カ ル デ バ イ ス 事 業</b>	<b>22.6</b>	<b>24.8</b>	<b>+ 2.2</b> (+ 9.9%)	<b>25.0</b>	<b>▲ 0.1</b> (▲ 0.7%)
<b>新 事 業</b>	<b>94.2</b>	<b>94.7</b>	<b>+ 0.5</b> (+ 0.6%)	<b>100.2</b>	<b>▲ 5.3</b> (▲ 5.4%)
<b>レ ー ザ 事 業</b>	<b>22.6</b>	<b>20.0</b>	<b>▲ 2.5</b> (▲ 11.0%)	<b>20.0</b>	<b>+ 0.0</b> (+ 0.4%)

こちらはセグメント別の売上高です。

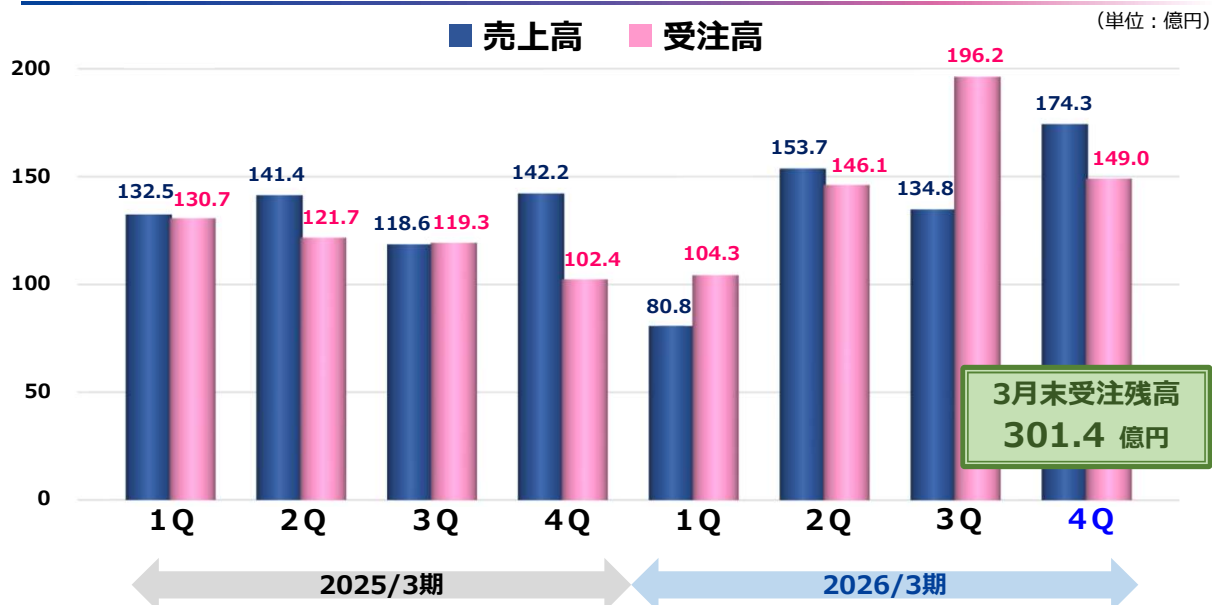
半導体事業につきましては、汎用メモリ向け投資の増加を背景に、台湾地域および中国地域向けの売上高が増加したほか、シンギュレーション装置の売上高が大きく伸長したことにより、前期比で2.2%増となりました。

医療デバイス事業につきましては、医療分野向けプラスチック成形品および組立品の需要が底堅く推移したことから、前期比で9.9%増となりました。

新事業につきましては、装置納入台数の増加や顧客稼働率改善を背景にTSSの売上高が増加し、前期比0.6%増となりました。

レーザ事業につきましては、主力製品であるレーザトリマ装置向けの設備投資需要が低迷した影響を受け、前期比11.0%減となりました。

## 受注・売上高の推移



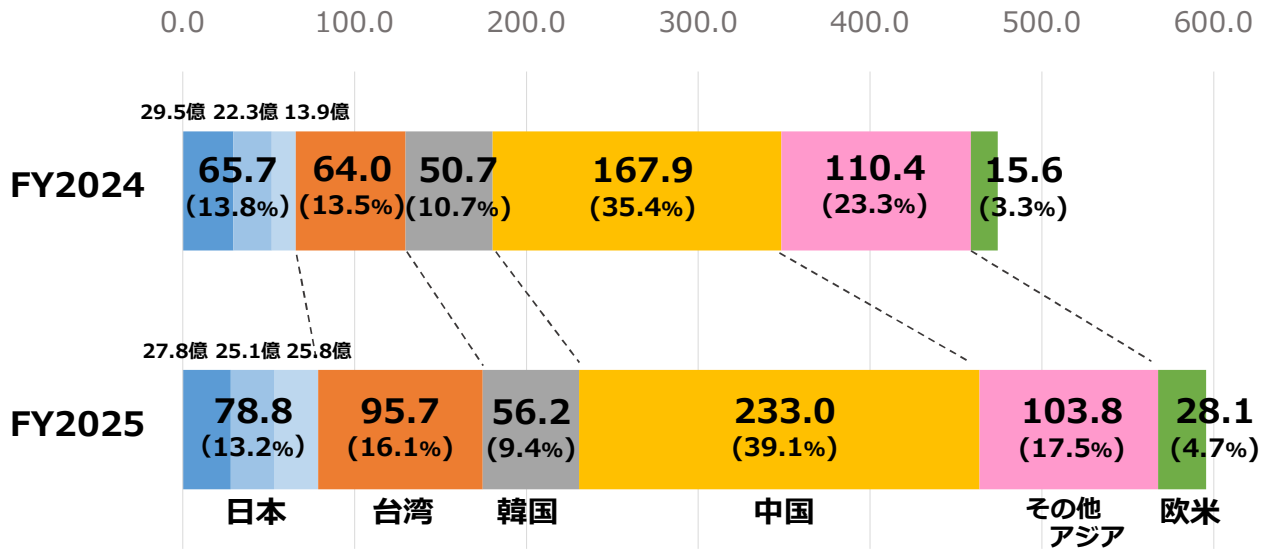
こちらは四半期ごとの受注・売上高の推移です。

受注高につきましては、第2四半期以降はメモリなどAI・データセンター向けを中心に好調な受注が継続しました。第4四半期の受注高は149.0億円と第3四半期比では減少しているものの、高い水準が続きました。

売上高につきましては、第1四半期は米国の関税政策の影響を受け低調なスタートとなったものの、受注残を着実に売上につなげることができました。

## 地域別受注構成比率（仕向地ベース）

（単位：億円）



※日本は左から半導体事業（新事業含む）、メディカルデバイス事業、レーザ事業



This material is the property of TOWA CORPORATION

8

こちらは地域別の受注高です。金額は仕向地ベースとなっております。例えば、韓国メーカーでも納入された地域が中国であれば、中国の受注高になっています。

台湾はメモリ増産に向けた投資やPLP（Panel Level Packaging）向けの受注が増加しました。

中国は、半導体内製化に向け、汎用メモリを中心に幅広い分野で堅調な受注が継続しました。

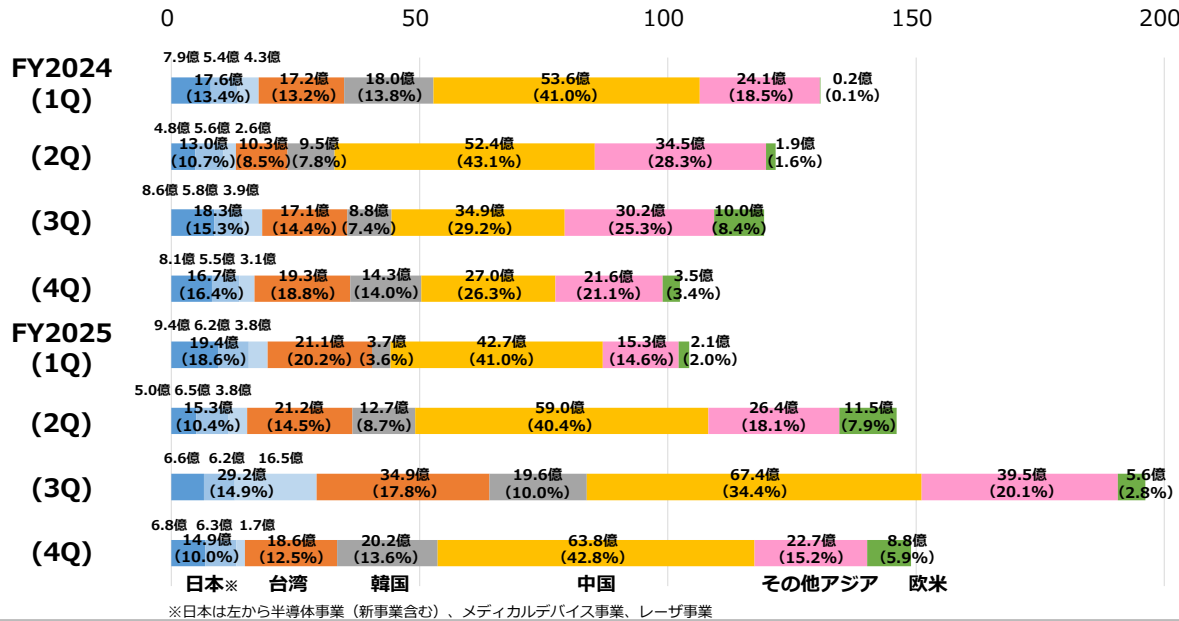
その他アジアは、前期比では減少となっているものの、堅調な受注が継続いたしました。

なお、詳細なデータを決算補足資料として当社Webサイトに掲載しておりますので、あわせてご参照ください。



## 地域別受注構成比率推移（仕向地ベース）

（単位：億円）



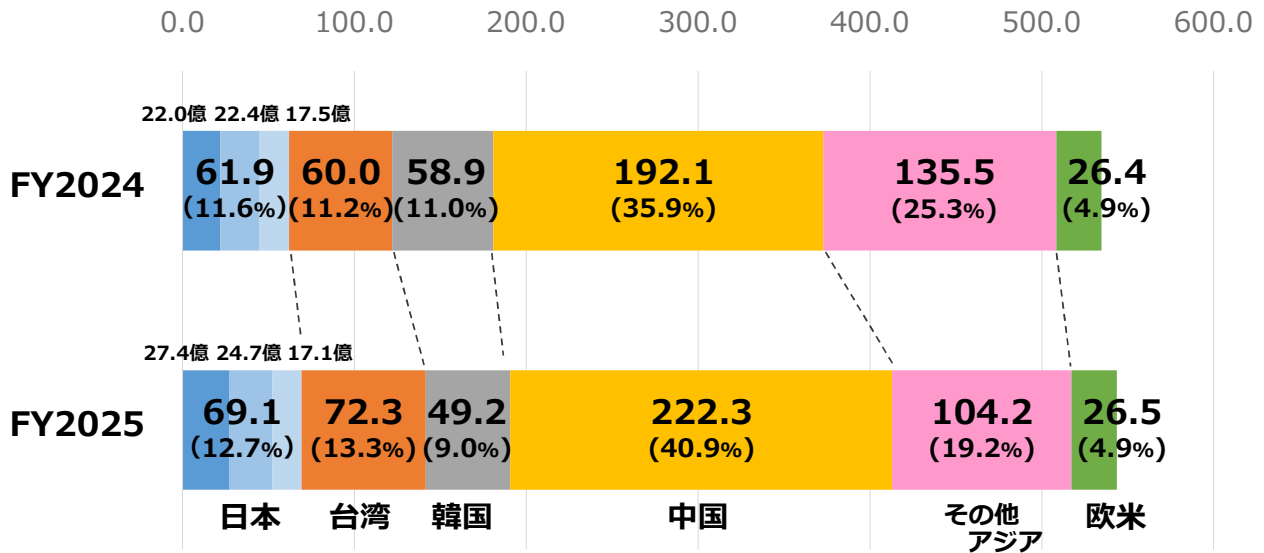
※日本は左から半導体事業（新事業含む）、メディカルデバイス事業、レーザ事業

こちらは四半期ごとの受注高推移について地域ごとにまとめたものです。

参考としてご覧ください。

## 地域別売上構成比率（仕向地ベース）

（単位：億円）



※日本は左から半導体事業（新事業含む）、メディカルデバイス事業、レーザ事業



This material is the property of TOWA CORPORATION

10

こちらは地域別の売上高です。受注と同様に金額は仕向地ベースとなっております。

台湾は、受注同様メモリ増産に向けた投資により売上高が増加しました。

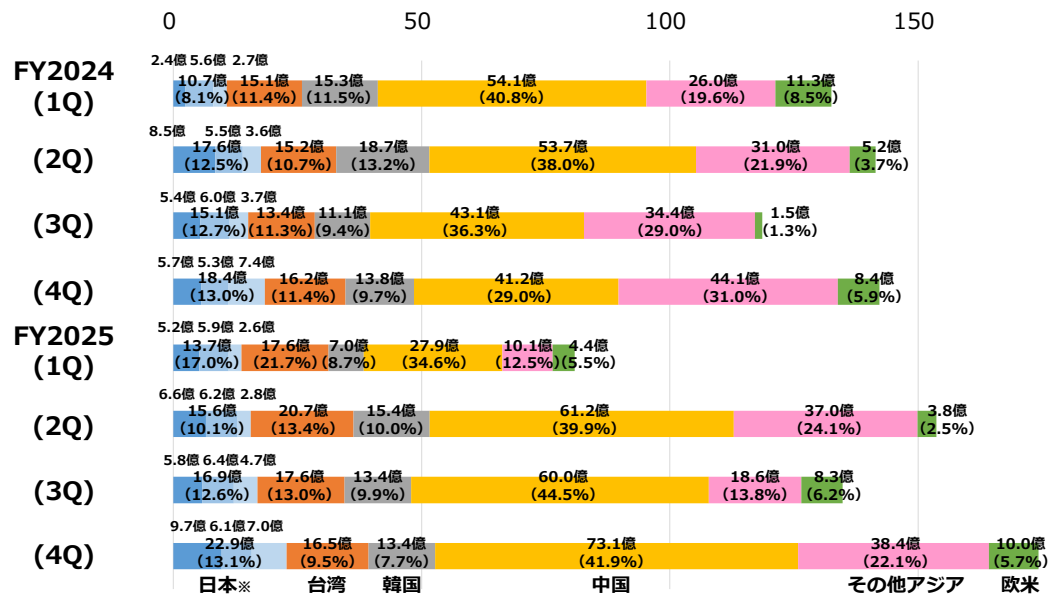
中国は、受注同様半導体内製化に向けた需要が継続しており、高水準の売上高が続きました。

その他アジアは、車載関連投資の一服により前期比で減少となりました。

なお、こちらも受注同様に、詳細なデータを決算補足資料として当社Webサイトに掲載しておりますので、あわせてご参照ください。

## 地域別売上構成比率推移（仕向地ベース）

（単位：億円）



※日本は左から半導体事業（新事業含む）、メディカルデバイス事業、レーザ事業



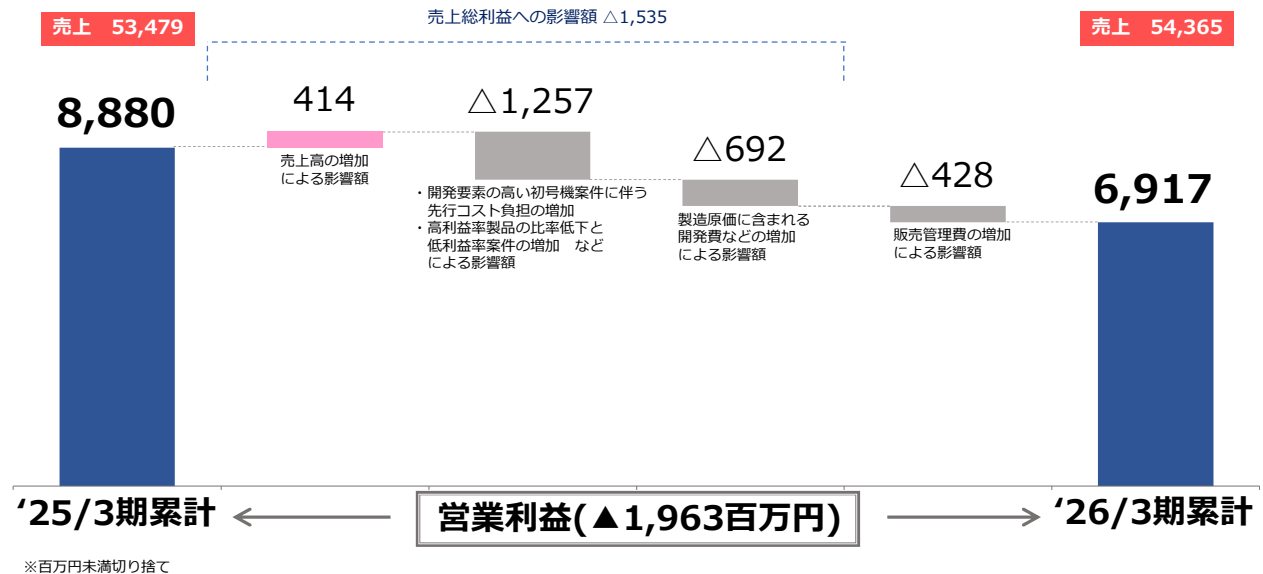
This material is the property of TOWA CORPORATION

こちらは四半期ごとの売上高推移について地域ごとにまとめたものです。

参考としてご覧ください。

## 2026年3月期累計 連結営業利益 増減要因分析（対前年同期比）

（単位：百万円）



こちらは、2025年3月期通期と2026年3月期通期の営業利益増減要因分析です。

売上高の増加により4億14百万円増となったものの、開発要素の高い初号機案件に伴う先行コスト負担の増加、高利益率製品の比率低下と低利益率案件の増加などによる影響で約12億57百万円減、製造原価に含まれる開発費などの増加による影響で6億92百万円減、販売管理費の増加による影響で4億28百万円減でトータル19億63百万円の減益となりました。

## 主な説明内容

---

1. 2026年3月期 実績

2. 2027年3月期 予想

3. TOPICS

## 2027年3月期 通期 連結業績予想

(単位：億円)

	2026/3期 実績	2027/3期 予想	増減額	前期比
売上高	543.6	640.0	+ 96.3	+ 17.7%
営業利益	69.1	102.4	+ 33.2	+ 48.0%
営業利益率	12.7%	16.0%	+ 3.3pt	-
経常利益	69.4	102.4	+ 32.9	+ 47.4%
当期純利益	45.9	70.0	+ 24.0	+ 52.4%

※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

こちらは2027年3月期の通期業績予想についてです。

通期の売上高は640億円、営業利益102.4億円、経常利益102.4億円、当期純利益70.0億円を予想しており、売上高は2年連続で過去最高を見込んでおります。前提となる市場環境などの詳細については、今期の市場見通しでご説明いたします。

想定為替レートは1ドル＝155円ですが、取引の大部分は円建てで行われており、為替変動による影響は軽微となります。

## 2027年3月期 セグメント別売上予想

(単位：億円)

	2026/3期 実績	2027/3期 予想	増減額	前期比
売 上 高	543.6	640.0	+ 96.3	+ 17.7%
半 導 体 事 業	403.9	484.3	+ 80.3	+ 19.9%
メ デ ィ カ ル デ バ イ ス 事 業	24.8	25.5	+ 0.6	+ 2.5%
新 事 業	94.7	97.7	+ 2.9	+ 3.1%
レ ー ザ 事 業	20.0	32.5	+ 12.4	+ 61.9%

こちらはセグメント別の売上予想です。

半導体事業については、前年比19.9%増、医療デバイス事業は2.5%増、新事業は3.1%増、レーザー事業は61.9%増を見込んでおります。

レーザー事業につきましては、特定案件に伴う一時的な売上計上を見込んでおり、前期比で約12.4億円の増収となる見通しです。

## 設備投資・配当予想

	2026/3期 実績	2027/3期 予想
設備投資	41.9億円	55.0億円
配 当	20.0円	24.0円

### ▶ 主な設備投資予定

- ・スマートファクトリー関連
- ・各工場における新規生産設備導入や更新による生産能力UP
- ・ラボ機能強化
- ・DX投資

◆ その他M&A等は積極的に実施

※配当方針「安定・継続配当」に基づき、4.0円増配の24.0円を計画しています。

こちらは設備投資と配当予想です。

2026年3月期の設備投資は、金型工場のスマートファクトリー化、各生産工場での生産体制強化に向けた設備投資などが中心でした。

2027年3月期につきましては、引き続き金型工場のスマートファクトリー化に向けた投資、各生産工場での生産体制強化に向けた設備投資など55億円を見込んでいます。

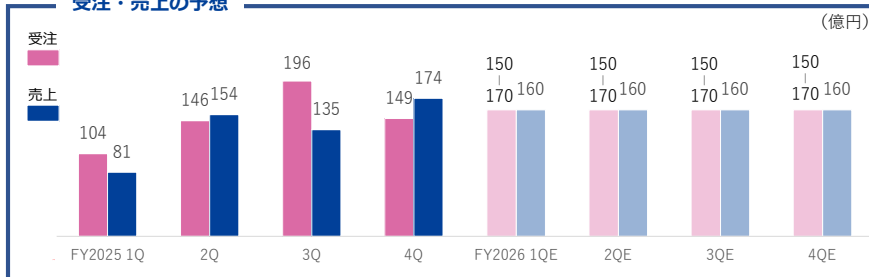
2027年3月期の配当につきましては、安定配当の施策や配当性向を考慮し、2026年3月期から4.0円増額の24.0円を予定しています。



## 市場見通し

- 受注** ▶ AI・データセンター関連の投資が引き続き牽引。  
▶ 先端パッケージ向けPLPの量産向け投資の開始を見込む。
- 売上** ▶ 受注残高や足元の受注水準から安定的な売上高を予想。
- 利益** ▶ 売上高の増加に伴い、利益率も前期比で改善を予想。  
▶ WLPにおける、市場ポジション強化を優先し、利益率は段階的な改善を見込む。

受注・売上の予想



### 受注高予想

1Q 2Q  
150-170億円 150-170億円

3Q 4Q  
150-170億円 150-170億円

### 損益予想

売上高	640.0億円
営業利益	102.4億円
経常利益	102.4億円
当期利益	70.0億円

こちらは、今期の業績予想の前提となる市場見通しについてです。

受注環境はAI・データセンター関連の投資が引き続き牽引をし、高い受注水準が継続する見通しです。

また、先端パッケージ向けではPLP（Panel Level Packaging）での量産投資の立ち上がりを下期以降に期待しています。

売上高につきましては、3月末時点の受注残高や足元の受注水準から安定的な売上計上を計画しています。

利益面では売上高の増加に伴い、利益率も前期比で改善を予想しています。一方、WLPにおける、市場ポジション強化を優先し、段階的な改善を見込んでいます。

## 主な説明内容

---

1. 2026年3月期 実績

2. 2027年3月期 予想

**3. TOPICS**

## 主な地域の受注動向予想

### 中国

- ▶ EV向けやパワーモジュール国産化投資が堅調
- ▶ メモリ需給逼迫を背景に関連投資も継続

### 台湾

- ▶ AIサーバー需要増を受けOSATでの生産が拡大
- ▶ PLP量産投資が下期以降に立ち上がる

### 韓国

- ▶ 顧客の工場スペース制約によりHBM投資は下期以降
- ▶ 足元では汎用メモリ投資が増加

### その他 アジア

- ▶ AI・データセンター向けに需要は底堅い
- ▶ インドで量産立ち上げにともない投資が拡大

主な地域の受注動向予想です。

#### 中国

EV向け投資やパワーモジュールの国産化投資は引き続き堅調に推移しています。加えて、世界的なメモリ需給の逼迫を背景に、メモリ関連の設備投資も継続しており、安定した受注環境が続いています。

#### 台湾

AIサーバー向け需要の拡大を背景に、OSATでの生産が広がっています。特に、生産性・コスト競争力に優れたPLP（パネルレベルパッケージ）については、量産投資が立ち上がり始めており、これらの動きは下期以降に本格化すると見えています。

#### 韓国

HBM関連の投資期待は引き続き高いものの、顧客側の工場スペース制約もあり、設備投資の中心は下期以降になる見通しです。一方で、足元では汎用メモリ向けの投資が増加傾向にあります。

#### その他アジア

AI・データセンター向け、EV向けを中心に需要は底堅く推移しています。特にインドでは、顧客の量産工場立ち上げを背景に、今後さらに設備投資が拡大すると見えています。

## HBM・先端パッケージ動向

### 市場環境

- 半導体市場はAI用途（HBM・GPU・AIアクセラレータなど）が成長を牽引。

### HBM

- 高い需要を背景に、メモリ各社はHBM量産投資を強化。
- コストや技術的な課題からMUF技術による生産が継続。

### 先端パッケージ

- カスタムASIC向けではOSATによる先端パッケージ向けの投資が増加。
- 生産キャパ拡大、生産効率UPに向けてPLP投資の増加を見込む。

HBMおよび先端パッケージ市場は、生成AIの急速な普及を背景に、かつてない成長局面を迎えております。

AI学習・推論の高度化に伴い、HBM、GPU、AIアクセラレータを中心としたAI関連半導体は市場全体の成長を力強く牽引しており、この構造的な成長トレンドは今後も継続する見通しです。当社にとっては、中長期的な事業拡大を後押しする極めて大きな追い風となっています。

HBM分野においては、AI用途の本格拡大を受け、メモリ各社が競争力強化に向けて量産投資を一段と加速させています。特に生産方式の面では、コスト競争力と技術的な安定性の観点から、当社が強みを持つMUF技術が今後も主流として継続される見通しであり、当社の事業機会は着実に拡大しています。

また、先端パッケージ分野では、カスタムASICを中心にOSAT各社の投資意欲が一層高まっています。加えて、生産能力の拡大と生産効率の飛躍的向上を目的として、PLP（パネルレベルパッケージ）への投資が本格化しつつあります。当社は、長年培ってきた独自のコンプレッション技術という明確な差別化軸を武器に、拡大する先端パッケージ需要を確実に取り込み、持続的な成長につなげてまいります。

## 第4次モールドイング革命 ～INNOMS～

### 半導体量産コストを“半分”に

「第4次モールドイング革命」として新たなスタンダードへ！

#### コンセプト

✓ 低コスト ✓ 大量生産 ✓ 環境負荷低減

#### ★ 新製品の特長

- ① 量産コスト約**50%**削減
- ② 1台当たりの**生産性2倍**
- ③ 設置面積約**40%**削減
- ④ 消費電力約**50%**、消耗品材料約**25%**削減
- ⑤ 幅広いパッケージに対応（メモリ、ロジック、QFN、RFモジュール等）



「低コスト」、「大量生産」、「環境負荷低減」をコンセプトに半導体パッケージ量産の在り方を根本から変える次世代コンプレッションモールドイング装置「INNOMS（イノモス）」を開発いたしました。

これまで両立が難しかった高生産性・省エネルギー・省スペースを高い次元で実現し、お客様の量産コスト構造そのものを変える装置として、「第4次モールドイング革命」と位置づけ、半導体後工程における新たなスタンダードを提案します。

新製品の特長は以下の5点です。

- ① お客様の量産コストを約50%削減
- ② 1台当たりの生産性を2倍へ
- ③ 高い生産性を確保しながら設置面積を約40%削減
- ④ 消費電力約50%、消耗品材料約25%削減し、ランニングコストおよび環境負荷を低減
- ⑤ メモリ分野を中心に、ロジック、QFN、RFモジュールなど多様なパッケージに対応

今後も半導体量産のコストと生産性に新たな基準を打ち立てることで、お客様の事業成長と、半導体後工程分野における持続的な価値創出に貢献してまいります。

T O W A ビ ジ ャ ン 2 0 3 2

# 「変革で世界の頂へ」



《本資料に関するお問合せ》TOWA株式会社 企画部

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5番地 Tel : 075-692-0251

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。